

关键指标

- 频率范围：2~20GHz
- 插入损耗：1dB(Typ.)
- 良好的输入/输出驻波比：1.4: 1
- 封装尺寸：4mm×4mm×1.2mm

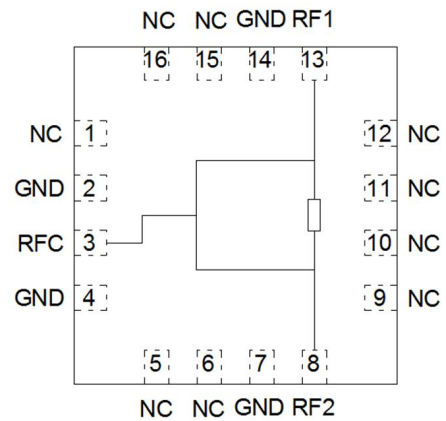
典型应用

- 雷达和电子对抗
- RF/微波电路
- 测试测量
- 仪器仪表

产品简介

HX838010AF4是一种 0° 超宽带功率分配器芯片，封装于 4×4QFN 壳体中，工作频率覆盖 2~20GHz，插入损耗约为 1dB(Typ.)，驻波比约 1.4(Typ.)。

功能框图



电性能 ($T_A=25^\circ\text{C}, Z_0=50\Omega$)

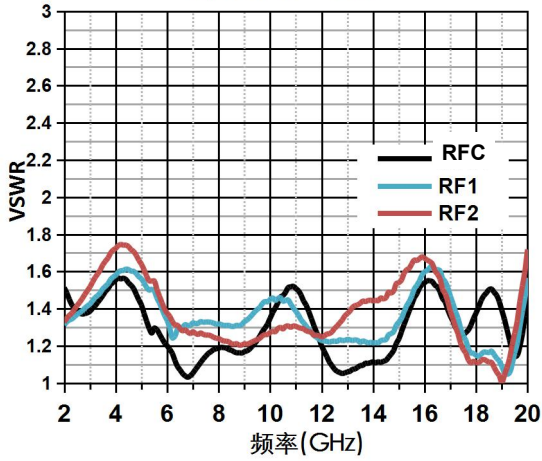
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位
			MIN	TYP	MAX	
频率范围	f	$Z_{in}=Z_{out}=50\Omega$ $T_A=+25^\circ\text{C}$	2	—	20	GHz
插入损耗	IL		—	-1	-1.5	dB
插损平衡	IP		—	±0.25	—	dB
RF1 驻波比	VSWR		—	1.4	1.8	:1
RF2 驻波比			—	1.4	1.8	:1
RFC 驻波比			—	1.4	1.8	:1
隔离度	ISO		-12	-20	—	dB

绝对最大额定值

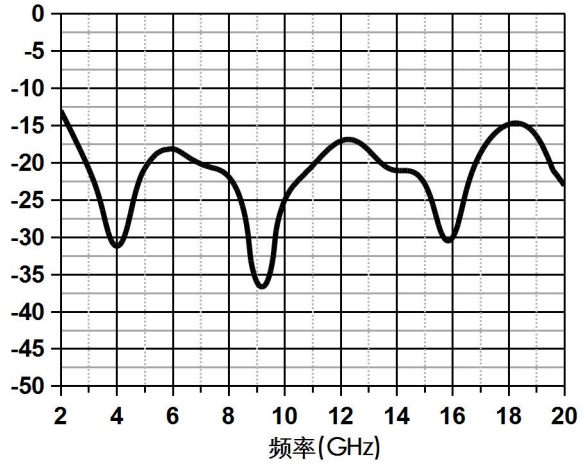
最大输入射频功率	+30dBm	工作温度	-55℃~+85℃
沟道温度	150℃	贮存温度	-65℃~+150℃

典型测试曲线

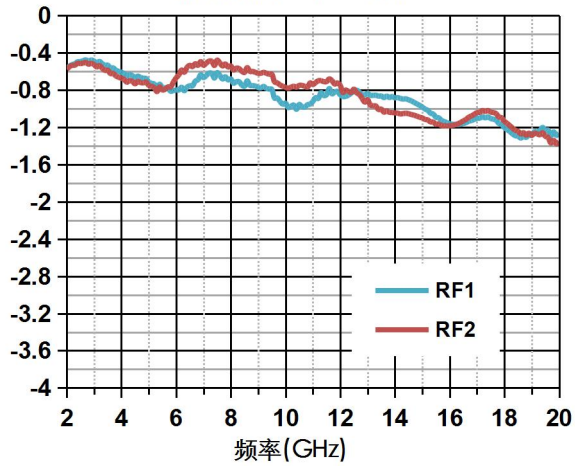
驻波比(:1) vs. 频率



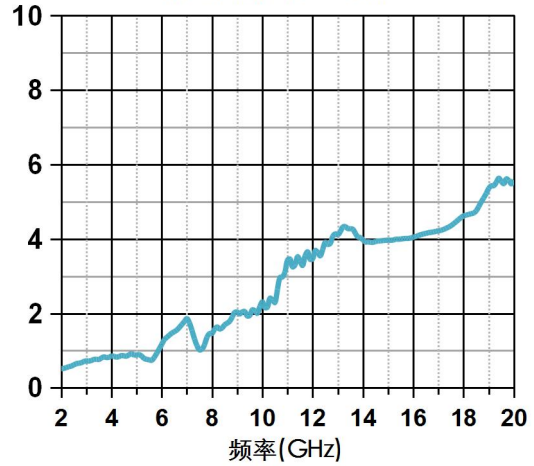
隔离度(dB) vs. 频率



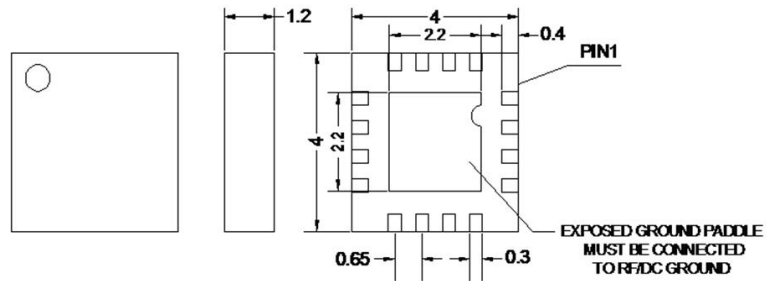
插入损耗(dB) vs. 频率



相位平衡(°) vs. 频率



外形和端口尺寸(mm)



注意事项:

- 1、产品防潮等级为 2a 级，存放环境小于或等于 30° C/60% RH，四周车间寿命；
- 2、撤除真空包装，上回流焊前需在 125+/-5° 环境中烘焙 6 小时，方可焊接。